

公司代码：688270

公司简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为了回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税）。截至2022年3月31日公司总股本109,210,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,251,170.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.60%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	臻镭科技	688270	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李娜	孙飞飞
办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号B幢6楼
电话	0571-81023677	0571-81023677
电子信箱	ir@greatmicrowave.com	ir@greatmicrowave.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务情况

公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。

2. 主要产品和服务情况

1) 终端射频前端芯片

报告期内，公司立足多年技术沉淀，不断推进产品创新、丰富货架产品型号。公司新研了 30 款功率放大器产品，满足电台、自组网通信、北斗导航、测控通信、数据链等多种应用需求；新研了 35 款低噪声放大器产品，覆盖 Sub-6GHz 频段，在电台、北斗导航、低轨卫星通信等领域有着广泛的应用；新研了 4 款射频开关产品，拥有 SPDT/SP5T/SP6T/SP8T 等多种切换模式，具备高耐受功率能力；其中以 GM1109、GM1110 为代表的功率放大器，具有大带宽、高功率特性，产品性能比肩国际友商，在电台、自组网通信等领域得到广泛应用，以 GMB2314 为代表的低噪声放大器，集成 bypass 功能，在通信终端客户中广受好评。

2) 射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片

报告期内，公司开展 4 款射频收发器及高速高精度 ADC/DAC 的研制工作，实现 3 款射频收发器及高速高精度 ADC/DAC 的定型量产，进一步巩固了在射频收发芯片器及高速高精度 ADC/DAC 领域的先发优势，持续推进了新产品定义与既有产品的性能提升。公司研发的四通道可同步 ADC、四通道高线性 DAC、低功耗时钟分发芯片配器实现量产，多项产品性能比肩国际友商，在国内终

端通信、相控阵通信、相控阵雷达、声呐设备、数据链、一体化综合电子系统等领域中已得到广泛应用；另外围绕客户需求、市场与技术发展趋势，公司定义了宽带射频收发芯片器、多通道高速高精度 ADC/DAC 等升级型产品，在工作频段、带宽等性能指标上实现进一步提升，维持技术优势；并定义了多通道低功耗高精度 ADC、窄带高线性收发芯片器等新型产品，其线性度、带内杂散、片上频综相噪等指标性能在窄带抗干扰通信领域具备竞争优势。

3) 电源管理芯片

报告期内，公司电源管理芯片团队形成了负载点电源芯片、低压差线性稳压器、T/R 电源管理芯片、MOSFET 驱动器、PWM 控制器、固态电子开关、微模块电源、电机驱动、电池均衡器等产品线。公司新研了 12 款低压差线性稳压器，输入电压覆盖-20V~40V 需求，满足航天器 FPGA、微处理器、ASIC 等负载点及 ADC、DAC、供电等多种应用需求。新研了 20 款 T/R 电源管理芯片，集成波控、调制、串并转换等功能于单颗芯片，满足 GaAs/GaN/CMOS T/R 射频通道漏极电源调制、栅极调节保护等应用需求。其中以公司 C41113RHT 为代表的高可靠低压差线性稳压器，具备高达 3A 的输出电流能力，最小压差低至 120mV，最小噪声低至 20 μ VRMS，并满足宇航环境适应性要求，性能优于国内外同类产品，可实现原位替代；公司自主定义的以 C49023RH 为代表的 T/R 电源管理芯片，包含串并转换、负压变换、电源调制、栅极控制、栅极调节等功能，可同时给 PA、LNA、DRV 供电，在 TR 组件用户中深受好评。

4) 微系统及模组

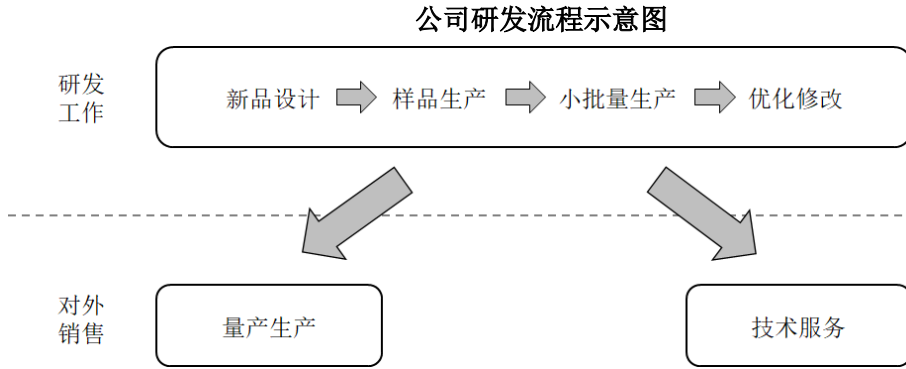
报告期内公司微系统及模组研发团队确立产品的研发方向为 TR 组件及射频微系统。公司新研 TR 组件 16 款，主要应用于相控阵雷达、低轨互联网通信卫星星座、数据链及和宽带通信等领域；新研微系统 5 款，其中 3 款射频硅基微系统，2 款中频硅基微系统，主要应用于数据链和雷达系统。公司的微系统产品相较于传统产品，通过多层内嵌芯片的三维堆叠极大地提高了功能集成度、产品重量大幅缩减至传统 TR 组件的 10%以内，并通过具有高一一致性的半导体晶圆级量产加工使成本缩减至原先的 30%，满足了新一代装备向小型化、高性能、低成本方向发展的需求。

(二) 主要经营模式

公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。报告期内，公司产品主要应用于特种行业领域，需要经过严密的设计、验证等研发环节后，方可进入量产生产阶段。公司主要通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品，同时采购封装材料对部分产品独立进行封装生产，产品交付前需完成相应的质量测试，最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。报告期内公司的经营模式未发生过重大变化。

1、研发模式

公司根据产品技术在行业内的发展趋势，以及下游客户的实际应用需求，开展新产品和新技术的研发工作。公司对集成电路芯片和微系统等产品完成新品设计、样品测试、小批量验证和修改验证后，开始向客户提供相关产品的量产销售，以及围绕相关产品的技术服务。



由于特种行业产品研制过程的复杂性、技术水平要求高、周期性长等特殊性的，公司在产品研制过程中，尚未完成公司内部定型时，会存在针对研制阶段的样品有需求的客户。针对部分新型号产品或新客户送样，公司与客户签订销售合同，将相关研发样品向客户销售。

此外，公司建立了明确的产品研发管理流程，具体包括研发立项、研发设计、样品验证等阶段。公司的产品研发工作由研发部来主导完成，同时生产部、质量部、采购部和市场部围绕产品研发任务提供支持服务，但不参与具体的产品开发工作。其中，研发部负责新产品和新技术的可行性论证，并主导芯片技术的开发工作；生产部和采购部根据研发部的要求负责执行生产任务和供应链的下单及沟通；质量部负责对半成品和产成品进行分批测试，以保证产品的质量和性能；市场部负责与客户的持续接洽，了解客户的产品需求，向研发部提供客户反馈。

（1）研发立项阶段

市场部通过与客户接洽，了解客户对产品的使用需求，研发部围绕技术难度、技术路径、市场需求等情况进行充分的论证，分析新产品开发的可行性，并形成新产品研发立项报告，提交项目评审会评审。新产品研发项目通过立项评审后即完成研发立项。

（2）研发设计阶段

新产品研发完成立项后，研发部根据新产品研发立项报告中规定的指标和要求开始进行产品设计，经过方案设计、电路设计、工艺设计、版图设计和仿真验证等环节论证后，再通过仿真设计、技术讨论、仿真测试等步骤初步确定技术方案，并由研发部组织召开技术评审会议。新产品研发项目通过技术评审会议后进行首件生产制造。

(3) 样品验证阶段

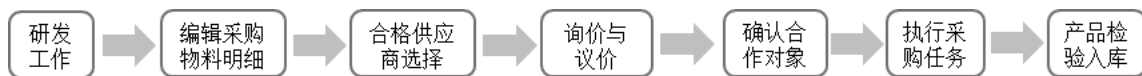
新产品研发设计完成后，生产部将向供应商下达工程样品生产和组装的指令。产品验证阶段主要是对样品的功能、性能、稳定性等方面进行测试，以判断产品是否达到设计标准和预期要求，通过首次样品验证、小批量样品验证、修改样品验证等多重验证程序确保产品的可靠性和质量标准。同时，质量部门将对该产品进行基于不同应用场景下的功能、性能、可靠性和环境适应性进行测试验证。样品通过所有验证环节并经过评审后，方可进入量产阶段。

2、采购和生产模式

报告期内，公司通过向供应商采购原材料、封装加工、委外服务和仪器设备，用于产品的研发和生产。公司基于下游客户的订单需求开展生产，提前向合格供应商下单采购各类芯片的晶圆等原材料，同时采购芯片封装所需的原材料对部分终端射频前端芯片进行自主封装加工，并将其他芯片的晶圆委托外部封装厂商进行封装加工生产，公司对封装后的成品独立进行测试，确保产品的性能和质量可以符合下游客户的要求。公司设立了生产部和质量部专门负责管理并监督芯片的生产过程，以保证产品的交付质量和交付时间。

公司建立严格的采购制度和进料检验规范。申请人提交采购申请单，经部门负责人审批后递交到采购部，采购人员核对采购申请单的物料信息并制定采购方案，在合格供方名录中选择两家以上供应商进行询价、比价、议价，选择合作对象后将所有信息汇总汇报并依采购核准权限核决，通过审批后执行采购任务。仓库依据采购订单收料并交由质量部按检验标准进行验收，通过验收后进行入库，由采购人员通知供应商开具发票，财务部收到发票后按合同约定的付款条件进行付款。

公司采购流程图



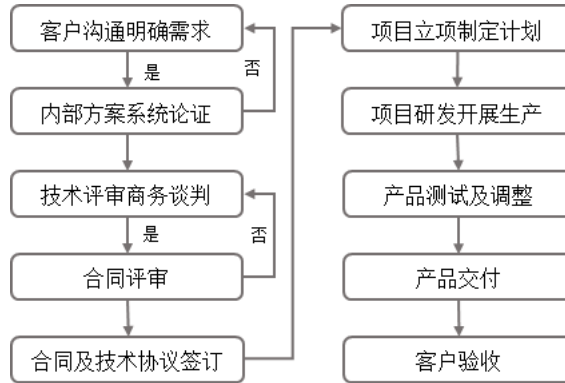
3、销售模式

公司作为特种行业领域核心芯片的供应商，下游客户主要为特种行业领域装备的制造商，公司采用直销模式向下游客户销售产品或提供技术服务。公司根据客户需求参与芯片和微系统的研制任务，产品通过客户应用验证后，公司开始量产芯片并销售给下游客户。下游客户采购公司芯片，并应用到各类装备中，最终销售给特种行业用户单位。

公司销售业务由市场部负责，形成了覆盖特种行业领域重点客户的销售体系。市场部主要负责市场调研、市场开拓、客户维护、商务谈判和项目管理。销售人员在获悉客户的需求后，将需

求传递至研发负责人，双方团队共同针对项目的可行性、盈利性、交付周期、发展前景以及关键技术等因素进行初步探讨，并交由管理层（涉及市场、技术、财务）进行审批，形成明确产品配置报价和技术方案。公司与客户通过商务谈判和技术评审，达成合作意向后，与客户签订合同和技术协议，成立项目组。公司主要销售流程如下：

公司销售流程图



4、定价模式

公司作为特种行业领域核心芯片的供应商，下游客户主要为特种行业领域装备的制造商，其制造的相关装备装配了公司芯片或微系统并销售给特种行业用户单位。公司与装备制造商协商产品定价，无需参与特种行业用户单位的招投标流程或产品审价。在产品定价前，公司综合评估产品功能定位、技术工艺难度、市场竞争力等因素，在产品生产成本的基础上，附加一定的毛利率后，对产品进行初始定价。下游客户的采购主要以询价、竞争性谈判、接受委托、邀请招标等方式进行内部比选，公司参与客户的内部比选，并提供相关研制方案及报价。客户基于核心器件的自主可控需求，综合产品性能指标、制造工艺技术难度、产品交付货期、产品供应稳定性等因素，选择符合要求的合格供应商，双方进行协商定价并签订合同，最终确定产品价格。

公司与客户的产品定价体系较为稳定，通常可以维持3年以上，合同价格即为最终产品价格，双方一般不再进行价格调整。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

公司主要产品为终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，属于集成电路设计行业。

根据海关总署统计，集成电路是我国第一大进口品类，2020 年全年进口集成电路 5,450.00

亿个，同比增长 22.94%，总金额 24,207.30 亿人民币，同比上涨 14.75%，约占我国进口总额的 18%。现阶段中国集成电路的进口量和进口占比仍然较大，集成电路国产替代空间亦较大，高端集成电路产品不能自给已经成为影响产业转型升级乃至国家安全的潜在风险，集成电路发展自主可控的意愿及需求极为迫切。为此，国家进一步加强了对集成电路产业的重视程度，制定了多项引导政策及目标规划，大力支持集成电路核心关键技术研发与产业化，力争提升集成电路国产化水平。2014 年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》明确规划出我国集成电路行业未来发展的蓝图，到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%；到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。从中长期来看，在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善带动下，中国集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。除了行业规模显著增长外，集成电路行业的产业结构也不断优化，附加值较高的设计环节销售额占集成电路行业总销售额比例稳步提高，从 2010 年的 25.28%，上升到 2020 年的 42.70%，已成为集成电路产业链中比重最大的环节。

(2) 所处行业的基本特点

1) 国产替代需求迫切

随着国际贸易摩擦的持续升温，高性能、高可靠射频模拟芯片已逐步成为贸易摩擦的重点领域。我国大多数射频模拟芯片极其依赖进口，尤其在高性能数模混合芯片领域，其自给率非常低。这对国内许多系统厂商形成了巨大的断供风险，并威胁到了国内整体行业的健康发展。因此，国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，并积极扶持国内射频模拟芯片企业。

2) 人才培养时间长

射频模拟芯片及微系统的设计，需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素，要求工程师既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，又要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，再加上射频模拟芯片的辅助设计工具少、测试周期长，使得设计师往往需要拥有丰富的设计经验才能设计出高性能的产品，因此，培养一名优秀的射频模拟芯片工程师往往需要 5-10 年甚至更长的时间。

3) 技术与可靠性要求高且产品附加值高

随着科学技术的进步与现代装备要求的不断提高，特种行业领域射频模拟芯片不仅要满足各类特种行业领域场景的多功能和高性能需求，还需要具备承受极端恶劣环境的高可靠性，保证芯片在高温、低温、真空、辐照、干扰等环境下依旧保持正常使用。特种行业产品设计对成本的敏

感度相对较低，更多的聚焦于产品部分技术指标的高性能和实际应用中的高可靠性。

因此，特种行业领域射频芯片在芯片设计、制造工艺、可靠性测试等环节的技术难度均有所增加，在前期需要更多的研发投入，相关行业也有着较高的供应商准入门槛。与此相对的，在产品研发完成后，由于产品的稀缺性，使得产品的附加值往往会远高于民用产品。

4) 客户关系稳定

公司主营业务涉及国家众多型号装备，因其特殊的应用场景及较高的准入认证门槛及多样的技术指标要求，使得大部分功能组件、子/分系统级产品配套关系较为固定，一旦产品定型，便不会轻易更换供应商。另一方面，公司已凭借优异的产品性能成为部分特种行业领域项目中的独家或核心供应商，部分产品国内其他厂商尚无同类性能产品，具备不可替代性。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务，通过多年来持续的资源投入和技术攻关，公司已推出终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等系列产品，并建立起科研生产、人才培养以及供应链等完整的体系，实现了高端集成电路芯片和微系统的工程化、产业化，形成了公司核心技术自主可控、业务可持续发展的能力。公司已成为国内特种行业领域通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一。

公司是国内少数能够在特种行业领域提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用，公司研制的射频芯片和电源管理芯片产品技术性能达到国际先进水平。

公司先后参与多家国防科工集团下属企业及科研院所的产品型号开发工作，相关产品已广泛应用在多个国家重大装备型号中，公司研制的终端射频前端芯片已应用于综合终端、北斗导航终端和新一代电台；射频收发芯片已应用于高速跳频数据链和数字相控阵雷达；电源管理芯片已应用于低轨通信卫星区域防护、预警、空间目标监测雷达；微系统及模组应用于通信卫星和机载载荷。

公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势。预计未来一定期间内，公司通过持续的研发投入和新产品开发，仍将在相关领域内保持有利地位。

公司专注于集成电路芯片和微系统的开发，相关产品作为特种行业领域装备的核心器件，报告期内主要应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域。随着特种行业领域装备升级和信息化建设，公司下游应用领域的需求将持续增长，并带动公司产品的市场空间不断扩大。

然而，由于特种行业领域的保密性要求，市场上尚无对特种行业领域芯片市场规模或市场占有率的公开统计数据。基于此，公司将通过各类产品在实际特种行业领域项目中的供应商地位来反映公司的市场地位，具体情况如下：

产品类别	实际应用项目中所占份额的说明
终端射频前端芯片	报告期内，公司销售的终端射频前端芯片主要应用于某无线通信终端项目，系该项目射频前端芯片的独家供应商
射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC	报告期内，公司销售的射频收发芯片主要应用于某无线通信终端项目，系该项目射频收发芯片的独家供应商； 报告期内，公司销售的中等采样率高速高精度 ADC/DAC 主要应用于 1MHz~6GHz 频段的特种行业领域无线通信终端等领域，系该等领域的核心供应商； 报告期内，公司销售的高等采样率高速高精度ADC/DAC主要应用于数字相控阵雷达通信系统、5G基站等领域的国产化替代需求，性能指标与国外先进产品相当，国内其他厂商尚无同类性能产品
电源管理芯片	报告期内，公司销售的电源管理芯片包括负载点电源芯片和固态电子开关芯片，主要应用于宇航及特种行业领域电子系统供配电领域，系该等领域内的主要供应商
微系统及模组	报告期内，公司销售的微系统及模组为定制化产品，销售金额和数量相对有限，暂未在实际应用项目中形成显著的份额

报告期内，公司在特种行业领域市场份额未发生重大变化，积极拓展民用领域如卫星互联网等的市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）5G 等通信技术发展对集成电路芯片的高集成度等性能指标提出更高要求

当前 5G 通信已全面开启商用，5G 通信技术对特种行业领域无线通信体制快速演进也产生了深远影响。无论是作为基础建设的 5G 基站，还是作为用户设备的智能终端，所使用的芯片都向着高集成度、高性能方向发展，传统 4G 的集成电路芯片无法满足 5G 苛刻要求，不可避免的需要对其集成电路芯片进行升级。作为通信领域的核心芯片，射频芯片和电源管理芯片的发展正处于增量阶段，市场需求还将持续增长。

（2）进口替代推动国内集成电路芯片供给侧繁荣

高性能射频芯片和电源管理芯片是特种行业领域终端和系统的核心组成，对于维护我国的国

家安全、实现科技创新战略具有重要的现实意义。我国目前的高端芯片主要依赖进口，产业整体的自给率很低，拥有巨大的国产市场替代空间。近年来我国增加了对集成电路产业的政策和资金扶持，这为国内厂商迎来了更好的研发环境和进口替代机会。随着本土集成电路芯片企业的崛起，有望开启进口替代浪潮。

(3) 民用集成电路技术助力国防科工信息化建设

我国特种行业领域高性能射频芯片的市场化程度具备提高的空间。特种行业电子产品，尤其是应用于现代化装备平台上的核心电子组件和小型系统级产品，一般为定制化产品，客户需求明确且高度集中。近年来我国电子信息技术已获得长足发展，具备了为特种行业信息化建设服务的条件。在整个集成电路市场上，我国民用市场占比远远高于特种行业领域市场。随着民用集成电路的技术实力持续增强，一些民营企业已经有条件、有实力支援特种行业信息化建设，未来将更多参与到特种行业元器件和模块的研发和生产过程中，为国防科工集团和下属单位进行配套生产。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	502,307,000.73	396,690,748.07	26.62	108,842,495.85
归属于上市公司股东的净资产	460,546,368.02	361,702,124.94	27.33	76,274,996.50
营业收入	190,580,502.14	152,124,067.16	25.28	55,449,854.49
归属于上市公司股东的净利润	98,844,243.08	76,935,982.81	28.48	4,185,334.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,368,423.91	72,959,167.93	23.86	4,005,714.91
经营活动产生的现金流量净额	4,754,923.17	11,088,622.88	-57.12	-12,728,316.34
加权平均净资产收益率(%)	24.04	38.16	减少14.12个百分点	5.81
基本每股收益(元/股)	1.21	0.94	28.72	/
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.94	28.72	/
研发投入占营业收入的比例(%)	21.26	19.92	增加1.34个百分点	41.9

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	27,773,263.95	55,965,661.91	16,350,217.49	90,491,358.79
归属于上市公司股东的净利润	9,521,979.83	31,395,409.09	400,289.29	57,526,564.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,512,979.83	29,247,238.06	-3,305,196.59	54,913,402.61
经营活动产生的现金流量净额	10,035,809.64	4,315,852.61	-19,599,059.37	10,002,320.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
郁发新	0	22,981,100	21.04	22,981,100	0	无	/	境内 自然 人

苏州荣通二号投资中心（有限合伙）	0	5,495,500	5.03	5,495,500	0	无	/	境内非国有法人
梁卫东	0	5,326,500	4.88	5,326,500	0	无	/	境内自然人
杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）	0	5,137,700	4.70	5,137,700	0	无	/	境内非国有法人
乔桂滨	0	4,305,500	3.94	4,305,500	0	无	/	境内自然人
杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）	0	4,305,500	3.94	4,305,500	0	无	/	境内非国有法人
宁波领汇股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,108,000	3.76	4,108,000	0	无	/	境内非国有法人
国投创业投资管理有限公司—国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,850,100	3.53	3,850,100	0	无	/	境内非国有法人
杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）	0	3,198,100	2.93	3,198,100	0	无	/	境内非国有法人
延波	0	2,771,400	2.54	2,771,400	0	无	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郁发新、杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）及杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

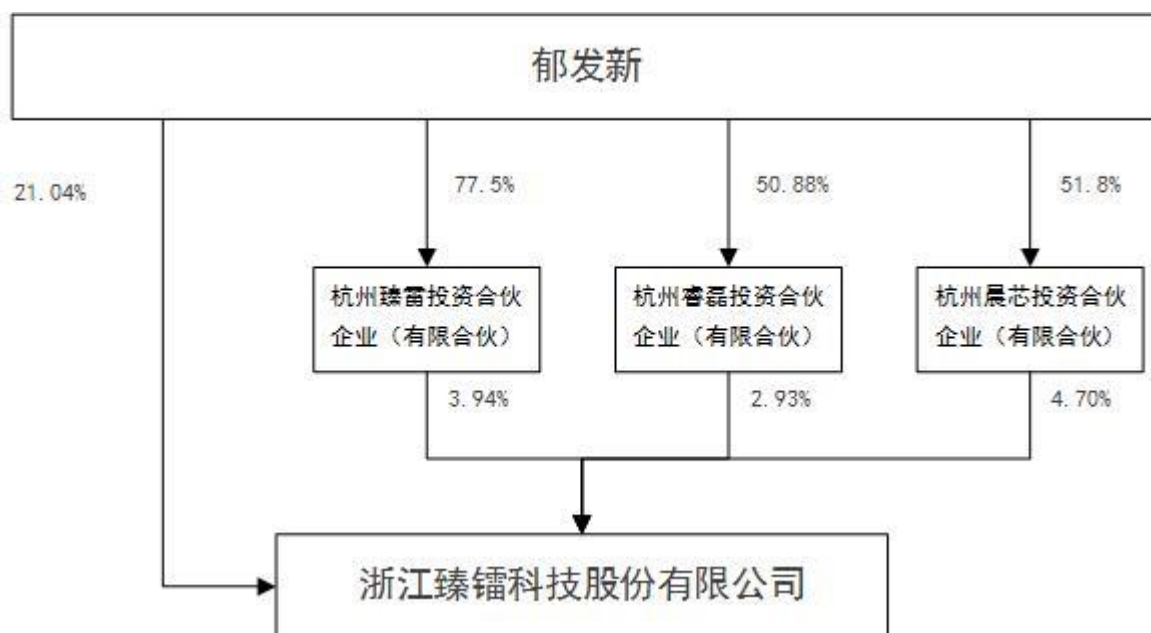
适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	郁发新	22,981,100	0	22,981,100	21.04	0	无
2	苏州荣通二号投资中心（有限合伙）	5,495,500	0	5,495,500	5.03	0	无
3	梁卫东	5,326,500	0	5,326,500	4.88	0	无
4	杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）	5,137,700	0	5,137,700	4.70	0	无
5	乔桂滨	4,305,500	0	4,305,500	3.94	0	无
6	杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）	4,305,500	0	4,305,500	3.94	0	无
7	宁波领汇股权投资合伙企业（有限合伙）	4,108,000	0	4,108,000	3.76	0	无
8	国投创业投资管理有限公司—国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,850,100	0	3,850,100	3.53	0	无
9	杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）	3,198,100	0	3,198,100	2.93	0	无
10	延波	2,771,400	0	2,771,400	2.54	0	无
合计	/	81,900,000	/	81,900,000	/	/	/

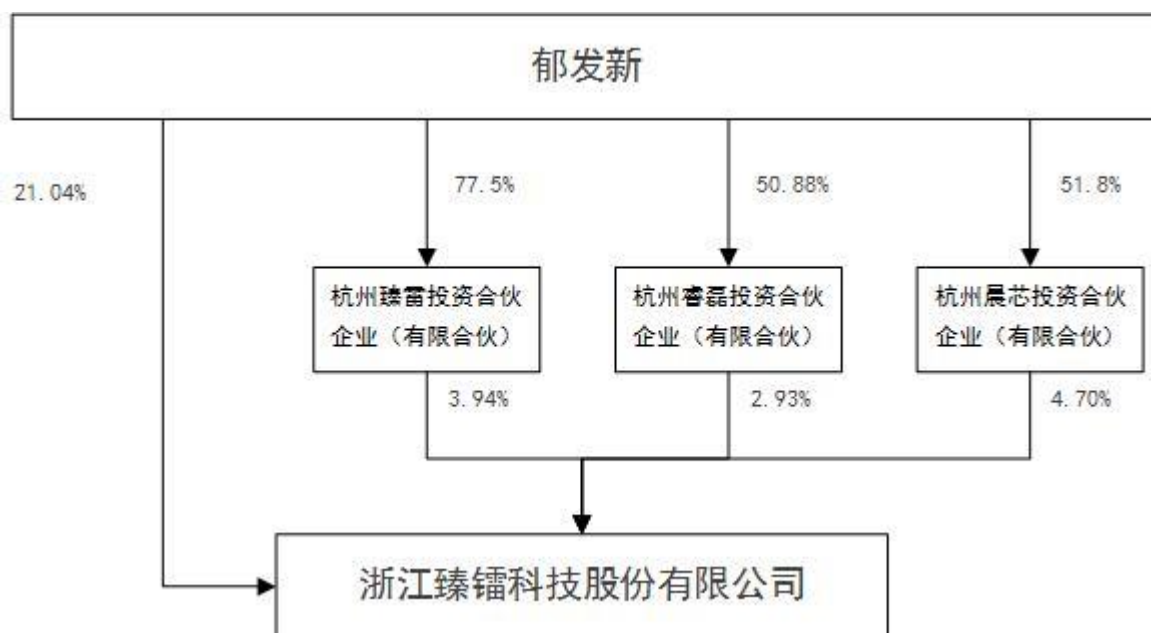
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现营业收入 190,580,502.14 元，较上年同期增长 25.28%。归属于上市公司股东的净利润为 98,844,243.08 元，较上年同期增长 28.48%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用